

# Technisches Datenblatt

## Wärmeleitpaste

### PA704

- silicon- und lösemittelfreie Wärmeleitpaste
- 1 Komponente
- CMR-frei \*
- hohe Effizienz und elektrisch isolierend
- exzellente Wärmeleitfähigkeit
- keine metallischen Füllstoffe
- hohe Langzeitstabilität
- sehr gute Kriecheigenschaften
- Anwendungsfelder: ideal für unterschiedlichste Entwärmungsaufgaben, verbessert den Wärmeübergang zwischen Feststoffen

\*) nicht CMR-kennzeichnungspflichtig

### Eigenschaften und Verarbeitung:

Typ / Art:	Nicht aushärtende und nicht eintrocknende Paste	
Viskosität:	150.000 ... 200.000 mPa·s	@ 22°C
Dichte:	2,20 ... 2.50 kg/dm <sup>3</sup>	@ 22°C
Farbe:	Natur (cremefarben)	
Haltbarkeit:	12 Monate im verschlossenen Originalgebinde bei trockener, kühler und dunkler Lagerung (15°C bis 25°C)	

## Stoffdaten:

---

Wärmeleitfähigkeit:	2.0 ... 2.3 W/(m·K) 2.0 ... 2.3 W/(m·K)	@ 22°C DIN EN ISO 22007 @ optional 60°C
Wärmestabilität:	Kein Ausblühen	nach 4h @ 200°C
Temperatureinsatzbereich:	-60°C ... +200°C	

---

## Elektrische Eigenschaften:

---

Durchschlagfestigkeit:	25 kV/mm	IEC 60243-1, VDE 0303, TI.2
Spezifischer Widerstand:	$10^{16} \Omega \cdot \text{cm}$	@ 23°C / 50% r.F. IEC 60243-1, VDE 0303, TI.30

---